29a-G6-8

3次元アトムプローブによるシリコン中の重水素分布観察

Observation of Deuterium Distribution in Silicon by Atom Probe Tomography

°高見澤悠¹、星勝也¹、清水康雄¹、井上耕治¹、矢野史子^{1,2}、永田晋二¹、四竈樹男¹、永井康介¹ ¹東北大金研、²東京都市大学:

^oH. Takamizawa¹, K. Hoshi¹, Y. Shimizu¹, K. Inoue¹, F. Yano^{1,2}, S. Nagata¹, T. Shikama¹, Y. Nagai¹

¹IMR Tohoku Univ., ²Tokyo City Univ.

E-mail: takami@imr.tohoku.ac.jp

シリコンを基板とした半導体デバイスにおいて、水素(H)は酸化膜界面や欠陥近傍のダングリン グボンドを終端することによって安定化させることや、バルク内でドナー・アクセプターを不活 性化させることが知られており、デバイス特性に大きく影響を及ぼすため、ナノスケールで空間 分布を把握することが求められる。しかし、H は特性 X 線が発生しないことや、チャンバー内の 残留ガスの影響などから従来手法では空間分布分析が困難であった。3 次元アトムプローブ(APT) 法は、元素の3 次元位置を原子レベルの位置分解能で観察可能な手法であり、飛行時間型の質量 分析によって元素を特定するため原理的には H まで分析可能である。しかし、APT 法においても チャンバー内の残留水素ガスの影響によって試料内部の水素を同定することは容易でない。

近年、水素の代わりに重水素(D)を用いて H のトラップサイトを評価することが提案されている。例えば、鉄鋼材料においては針状に加工した試料を高圧の D₂ 雰囲気中に保持し、直後にAPT 測定することによって D の 3 次元分布観察が報告されている[1,2]。本研究ではシリコンに D をイオン注入し、その空間分布をナノスケールで分析することを試みた。

本研究では、シリコン(100)基板に重水素イオン(D_2^+)を注入(10 keV, 1×10¹⁶ atoms/cm²)した試料を 作製し、表面に保護層として金のスパッタ膜を形成した後に、集束イオンビームを用いて試料を 針状に加工し、APT 観察を行った。

Fig.1 に APT 法で得られた質量スペクトルを示す。(a)の D をイオン注入した試料では、(b)の単結晶シリコン試料に比べて質量数/電荷が 2 のピークが高く、シリコンの同位体比率と一致、且つ 質量数/電荷が大きい側に 2 だけシフトしてピークが新たに観察された。これらのピークを用いて、 D 及び SiD の 3 次元分布を得た。Fig.2 に APT 法によって得られた D 注入した試料中の元素(H, D, SiD)分布を奥行き方向 20 nm で投影した図を示す。H はチャンバー内の残留ガスに依存する成分 であり、測定時間とともに増大する傾向にある。一方で、D や SiD は試料表面から浅い領域で高 濃度に分布していることから、チャンバー内の残留ガスと区別して分析できていることが分かる。 また、D 及び SiD は試料表面から浅い領域で凝集体を形成していることが見て取れる。これは、 イオン注入によって生成された欠陥周囲に終端した D を観察したためと考えられる。

以上の結果、APT 法を用いてシリコン中のDの空間分布観察が可能であることを示した。また、 シリコンに終端したDを観察可能であることから、欠陥や界面近傍にDをトラップさせることで、 それらの3次元分布観察への応用が期待できる。本講演ではイオン注入のモンテカルロシミュレ ーション結果と、透過型電子顕微鏡を用いた欠陥分布評価結果と併せて報告する。



[1] J. Takahashi, *et al.*, Scripta Mat. 67 (2012) 213. [2] R. Gemma, *et al.*, Scripta Mat. 67 (2011) 903 (a) Deuterium implanted

(b) silicon substrate (B doped)



Fig.2 Three dimensional elemental maps in deuterium implanted sample